

证券代码：002916

证券简称：深南电路

### 深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-48

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
活动参与人员（排名不分先后）	博时基金、长城基金、创金合信基金、财通证券、东吴证券
上市公司接待人员	战略发展部总监、证券事务代表：谢丹；投资者关系经理：郭家旭
时间	2024年7月26日
地点	公司会议室
形式	实地调研
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>交流主要内容：</b></p> <p><b>Q1、请介绍公司 2024 年上半年业绩预增情况。</b></p> <p>2024 年上半年，公司把握行业结构性机会，加大各项业务市场拓展力度，订单同比增长，产能稼动率保持在良好水平，业务收入实现同比增长，同时由于 AI 的加速演进及应用深化，叠加通用服务器迭代升级等因素，公司产品结构优化，助益利润同比提升。相关业绩预告数据为公司财务部初步核算结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2024 年半年度报告中详细披露。</p> <p><b>Q2、请介绍公司目前 PCB 业务产品下游应用分布情况。</b></p> <p>公司在 PCB 业务方面从事高中端 PCB 产品的设计、研发及制造等相关工作，产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。</p> <p><b>Q3、请介绍公司 PCB 业务通信领域近期经营拓展情况。</b></p>

公司 PCB 业务长期深耕通信领域，覆盖各类无线侧及有线侧通信 PCB 产品。2024 年一季度以来，无线侧通信基站相关产品需求较去年第四季度未出现明显改善，有线侧交换机、光模块等产品需求有所增长。

**Q4、请介绍当前 AI 领域的发展对公司 PCB 业务产生的影响。**

伴随 AI 的加速演进和应用上的不断深化，ICT 产业对于高算力和高速网络的需求日益紧迫，各类终端应用对边缘计算能力和数据高速交换与传输的需求迎来增长。公司 PCB 业务在高速通信网络、数据中心交换机、AI 加速卡、存储器等领域的 PCB 产品需求将受到上述趋势的影响。

**Q5、请介绍公司 PCB 业务汽车电子领域近期经营拓展情况。**

汽车电子是公司 PCB 业务重点拓展领域之一，主要面向海外及国内 Tier1 客户。公司以新能源和 ADAS 为主要聚焦方向，主要生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品，其中 ADAS 领域产品比重相对较高，应用于摄像头、雷达等设备，新能源领域产品主要集中于电池、电控层面。2024 年一季度以来，公司 PCB 业务在汽车电子领域继续把握新能源和 ADAS 方向的机会，聚焦国内外目标客户的开发突破，推进定点项目需求的释放。

**Q6、请介绍公司 PCB 业务 HDI 工艺能力及相关产品布局情况。**

HDI 作为一项平台型工艺技术，能够实现 PCB 板件的高密度布线。公司 PCB 业务具备包括 Any Layer（任意层互联）在内的 HDI 工艺能力，主要应用于通信、数据中心、工控医疗、汽车电子等下游领域的部分中高端产品。

**Q7、请介绍公司封装基板业务近期经营拓展情况。**

2024 年一季度以来，公司封装基板业务 BT 类产品需求整体延续去年第四季度态势，部分细分领域产品结构随下游需求波动有所调整；FC-BGA 封装基板各阶产品对应的产线验证导入、送样认证等工作有序推进。

**Q8、请介绍公司封装基板业务在 FC-BGA 技术能力方面取得的进展。**

公司 FC-BGA 封装基板已具备 14 层及以下产品批量生产能力，14 层以上产品具备样

	<p>品制造能力。公司后续将进一步加快高阶领域产品技术能力突破和市场开发，同时也将继续引入该领域的技术专家人才，加强研发团队培养，提升巩固核心竞争力。</p> <p><b>Q9、请介绍公司无锡基板二期工厂、广州封装基板项目连线爬坡进展。</b></p> <p>公司无锡基板二期工厂于 2022 年 9 月下旬连线投产，目前已实现单月盈亏平衡。广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线，目前其产能爬坡尚处于前期阶段，重点聚焦平台能力建设，推进客户各阶产品认证工作。</p> <p><b>Q10、请介绍公司近期 PCB 及封装基板工厂稼动率较一季度变化情况。</b></p> <p>公司近期 PCB 工厂稼动率较 2024 年第一季度有所增长，封装基板工厂稼动率相对保持平稳。</p> <p><b>Q11、请介绍上游原材料价格变化情况及对公司的影响。</b></p> <p>公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多，就公司成本端而言，2023 年至 2024 年一季度原材料价格整体相对保持稳定。近期受大宗商品价格变化影响，贵金属等部分辅材价格有所上升，部分板材价格亦有抬头趋势，目前暂未对公司经营产生明显影响。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通。</p> <p><b>Q12、请介绍公司泰国项目规划及当前建设进展。</b></p> <p>公司为进一步拓展海外市场，满足国际客户需求，在泰国投资建设工厂，总投资额为 12.74 亿元人民币/等值外币。目前已筹备并开展各项建设工作，具体投产时间将根据后续建设进度、市场情况等因素确定。</p>
<p><b>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</b></p>	<p>调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p><b>附件清单</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2024 年 7 月 26 日</p>